

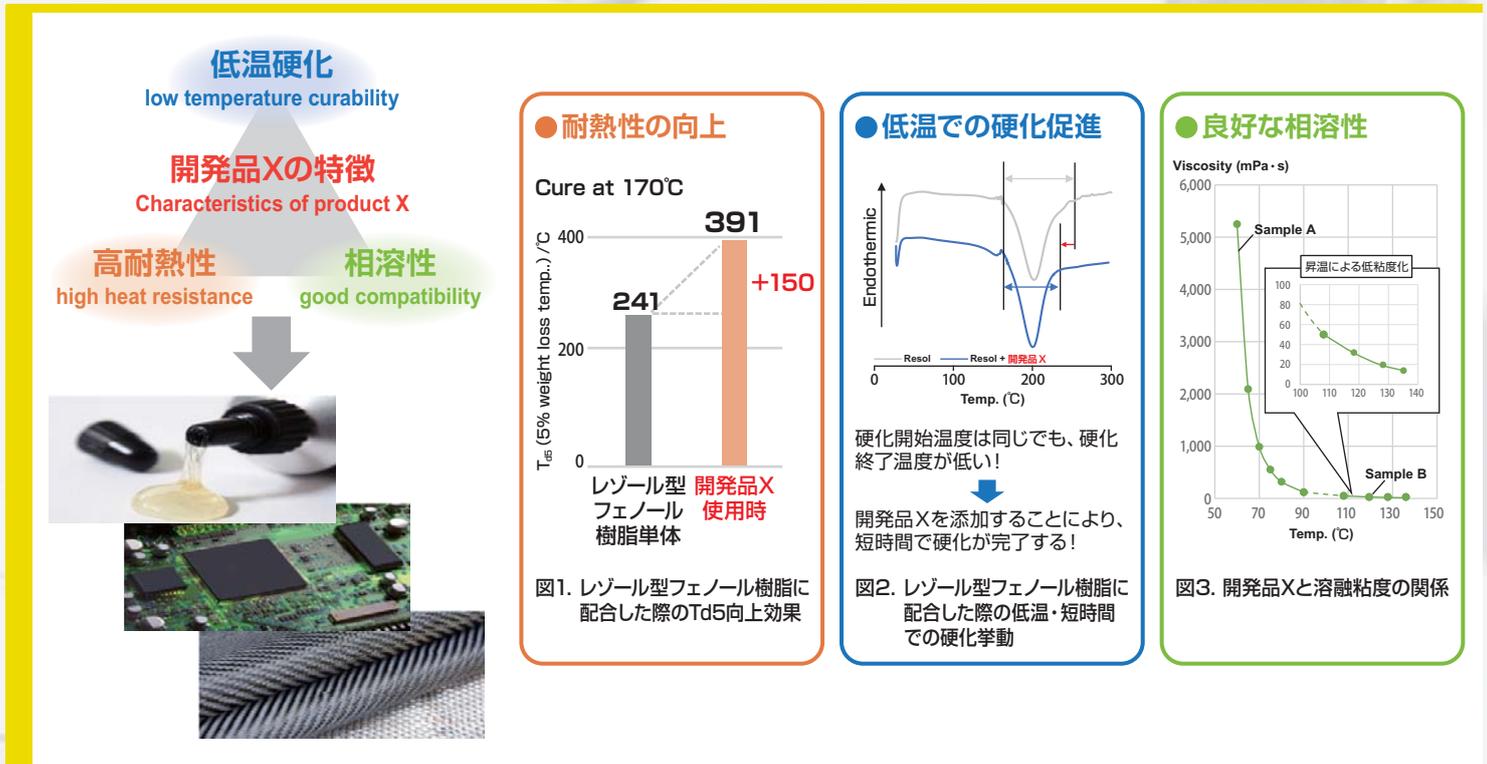
開発品X (仮製品名「HPCA-1」)

開発品

※仮の製品名のため、実販売の際は名称が変更となる可能性があります。

開発品Xはレゾール型フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂へ硬化剤として使用することで、低温での硬化、硬化物の耐熱性向上、また良好な相溶性による各種機能性を発現します。

To thermosetting (e.g. resol) resins, Developed Product X will affect multiple functions, promoting curing at low temperatures, improving the heat resistance of cured composition and holding high compatibility.



ビフェノール

Biphenol

ビフェノールは液晶ポリマー、サルホン樹脂等のスーパーエンジニアリングプラスチックの原料として使用されています。剛直なビフェニル骨格を樹脂に導入することで耐熱性や低誘電性に寄与する事例があり、次世代通信向け高周波材料への使用が期待されます。

Biphenol is used for super engineering plastics such as liquid crystalline polymers(LCP), polysulfones(PPSU). Introducing a rigid biphenyl skeleton into resins may contribute to heat resistance and low dielectric properties. Biphenol is expected to be used in high-frequency materials for next-generation communication.

